

安徽耐科装备科技股份有限公司

证券简称：耐科装备

证券代码：688419

编号：2026-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他_____
参与单位名称及人员姓名	惠升基金 田毅潇 国联民生证券 周晓萌 猎鹰资产 茹 意 西部证券 徐 凡 鑫泉资本 冯希平 国信证券 库宏垚 上海清淙 马 帅
时间	2026年04月07日
地点	现场
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：黄戎、董事会办公室职员：刘胡洁
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、会议交流（会议交流内容如下）</p> <p>1、简单介绍企业情况</p> <p>公司主要从事应用于半导体封装和塑料挤出成型领域的智能制造装备的研发、生产和销售，装备主要服务于两类细分领域，其中半导体封装装备主要服务于下游半导体封装领域，挤出成型装备主要服务于下游塑料型材挤出成型领域。</p> <p>其中半导体封装装备以国内销售为主，目标是实现进口替代，已与通富微电、长电科技、华天科技等国内头部封装企业建立长期合作关系，正逐步开拓境外客户，目前</p>

已成功与东南亚安世、英飞凌半导体等客户建立合作。挤出成型装备以出口为主，产品远销全球 40 多个国家和地区，服务 400 余家国外客户，服务于欧美等众多全球著名品牌，出口规模连续多年位居我国同类产品首位。

2、近两个月半导体封装装备接单情况？

随着人工智能(AI)、先进消费电子、云计算等新兴领域需求持续爆发，全球半导体市场正迎来强劲上升周期，作为产业链半导体封装装备供应商，目前在手订单充足。

3、半导体封装装备每月的产能？形成订单到交货期时间？

半导体封装装备为定制化产品，根据客户需求生产，因产品结构、技术参数不同，制造加工周期也不同。以公司半导体全自动封装设备 180T 一拖四标准化产品为例，一般交货周期为 4-6 个月左右。

4、下游市场景气度怎么样？

根据相关情况了解到，目前下游客户大部分属于满产状态。

5、三大封装厂客户采购的设备中耐科装备的占比情况？

三大封装厂都是公司的主要客户，与公司是长期合作关系，但客户的设备采购是客户的商业秘密，无相关数据。

6、一般采购签订数量是几台还是几十台？

一般签订数量一次合同签订为几台。

7、半导体封装装备国外订单是否形成销售？

2025 年已形成少量销售，销量不大，根据在手订单情况，2026 年海外销售将有显著的提升。

8、今年半导体封装装备订单将主要以海外为主吗？

公司半导体封装装备主要以国内销售为主，随着海外市场拓展，海外订单显著提升。

	<p>9、半导体海外主要有哪些客户？</p> <p>目前形成海外订单的有 Infineon Technologies (Malaysia) Sdn Bhd、Nexperia Malaysia Sdn. Bhd. 等多家客户，随着海外市场的开拓，规模将不断扩大。</p> <p>10、国外基板级粉末封装设备定价在 800-1200 万，贵司的基板级粉末封装设备预计定价在哪个区间？</p> <p>公司基板级粉末封装设备正处于研发测试完善阶段，暂无定价。</p> <p>11、现阶段半导体封装装备订单充足是否考虑外协？</p> <p>因订单充足，生产饱满，有部分工序需要通过外协加工辅助。</p> <p>12、今年挤出业务毛利率是否会继续提升？</p> <p>公司挤出成型装备主要销往欧美等 40 多个国家和地区，产品销售国家和地区不同，毛利率会有略微差距。</p> <p>二、现场参观</p> <p>现场参观了两类业务研发现场及制造车间，观看了采用压塑成型工艺的基板类封装装备及板级/晶圆级封装装备试制样机。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 4 月 7 日